

## 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初 占用资金余 额	2024 半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度占 用资金的利息 (如有)	2024 半年度 偿还累计发 生金额	2024 年 6 月 30 日占 用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联 方及附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初 占用资金余 额	2024 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度往 来资金的利息 (如有)	2024 半年度 偿还累计发 生金额	2024 年 6 月 30 日占 用资金余 额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	惠伦晶体(重庆)科技有限公司	子公司	应收账款	7,717.32	6,056.90		5,400.00	8,374.22	销售货款	经营性往来
	惠伦晶体(重庆)科技有限公司	子公司	其他应收款	9,530.76	5,770.00			15,300.76	代收款项	经营性往来
	惠伦晶体(重庆)科技有限公司	子公司	预付账款	11,313.83	11,063.63		13,175.38	9,202.08	采购货款	经营性往来
	惠伦晶体科技(深圳)有限公司	子公司	应收账款	2,633.36	4,521.41		3,193.17	3,961.60	销售货款	经营性往来
	惠伦晶体科技(深圳)有限公司	子公司	预付账款		92.14		27.45	64.69	销售货款	经营性往来
	陕西惠华电子科技有限公司	合营企业	应收账款	110.72	7.27			117.99	销售货物	经营性往来
	东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司	子公司	应收账款	15.95	13.19		20.29	8.85	销售货物	经营性往来
	香港惠伦实业有限公司(韩国)	二级子公司	应收账款		0.53			0.53	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	珠海惠世隆科技有限公司		应收账款	554.99	947.32		778.20	724.11	销售货物	经营性往来
	邢越		其他应收款		9.50		5.05	4.45	备用金	经营性往来
	深圳市瑞承伟业科技有限公司		其他应收款	175.00				175.00	增资款	非经营性往来
<b>总计</b>			<b>—</b>	<b>32,051.93</b>	<b>28,481.89</b>	<b>-</b>	<b>22,599.54</b>	<b>37,934.28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

法定代表人：赵积清

主管会计工作负责人：赵积清

会计机构负责人：邓又强